

株式情報

平成21年3月31日現在

発行可能株式総数	102,000株
発行済株式総数	33,405株
株主数	2,528名

■大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社イー・アンド・デイ	10,216	30.58
富加津 好夫	4,415	13.21
新田 純	830	2.48
生江 隆男	500	1.49
山川 陽光	485	1.45
崎山 武美	464	1.38
東 祥弘	456	1.36

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	毎年3月31日
売買単位	1株
株主名簿管理人	〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	TEL：0120-78-2031 (フリーダイヤル) 取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国 各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店 および全国各支店で行っております。

■住所変更、株式の買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

■株主様のご住所・お名前に関する文字についてのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

会社概要

平成21年3月31日現在

会社名	株式会社ホロン (HOLON CO.,LTD.)
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-5 新宿土地建物第11ビル3F TEL：03-3341-6431(代)
設立	昭和60年5月
資本金	6億9,236万円
代表者	穴澤 紀道
従業員数	42名
事業内容	半導体検査装置の開発、 製造、販売、保守サービス

役員

平成21年6月26日現在

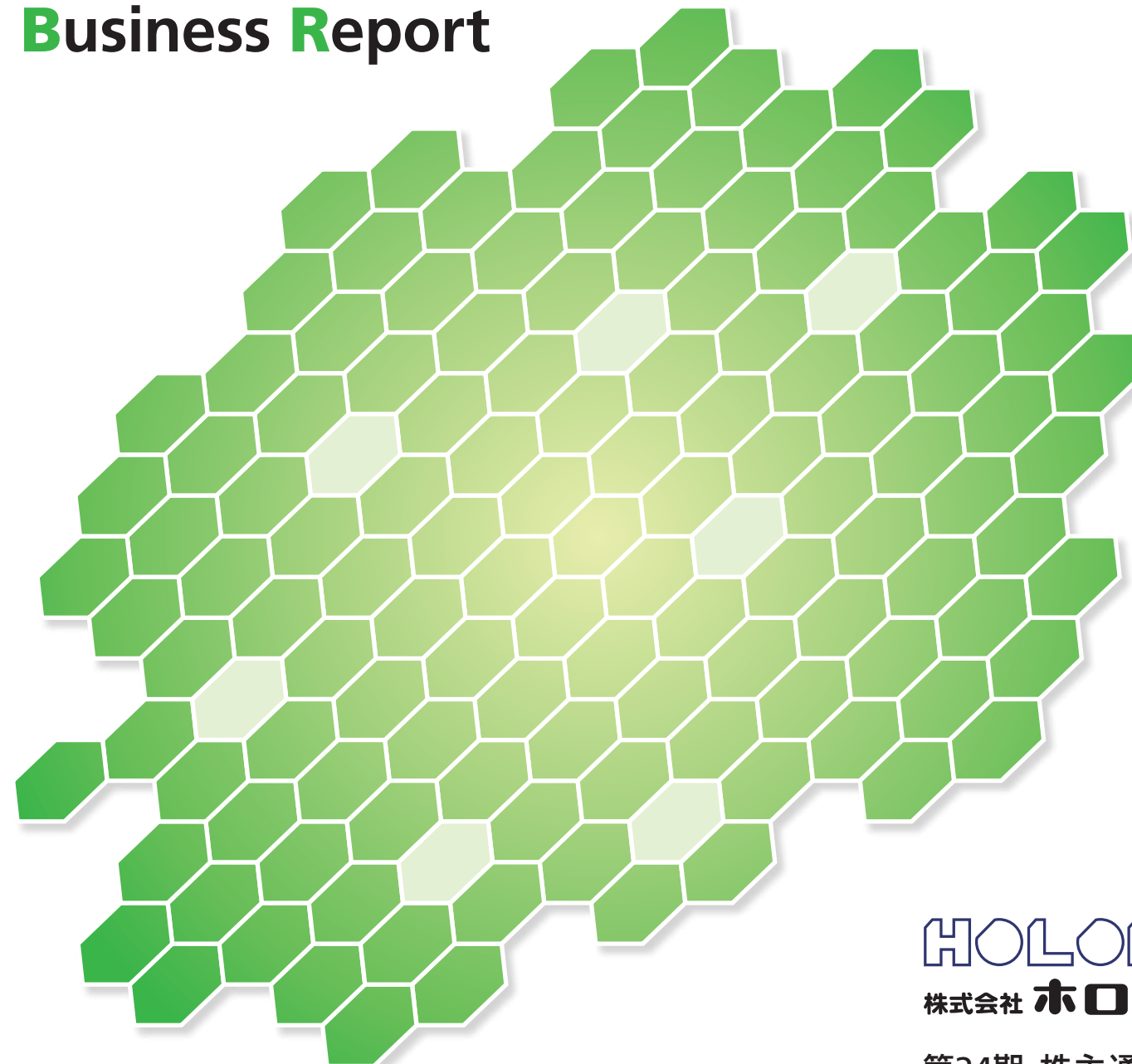
代表取締役社長	穴澤 紀道
常務取締役	新田 純
取締役	加藤 邦彦
取締役	大島 道夫
取締役相談役	富加津 好夫
取締役	古川 陽
常勤監査役	生江 隆男
監査役	有賀 益千代
監査役	三澤 順一

※監査役 有賀益千代及び三澤順一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

会社情報、IR情報は、ホームページでご覧いただけます。

<http://www.holon-ltd.co.jp/>

Business Report





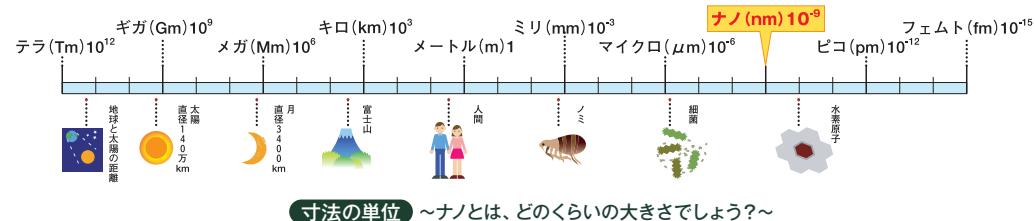
代表取締役社長

穴澤 紀道

技術開発から設計、製造まで正確な技術伝達を行い製造のレベルアップを推進するとともに販促活動の更なる強化を目標に人員の配置転換や専門部門の新設を行い、また、若手技術者の登用を多くして次世代に向けた体制作りを進めているところでございます。

当社の置かれた環境の厳しさは一朝一夕には変わりませんが、今後も当社の主要株主である株式会社イー・アンド・デイの資金・技術両面での協力を得て、継続的な受注獲得に向けて更なる製品性能アップで優位性を追求することにより市場競争力を強化し、企業価値を高めていくことに尽力していく所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。



ホロンのものさしはナノメートル。見えない世界を測ります。

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当期におけるわが国経済は、米国発の金融危機を発端にした世界的な景気減速が半導体業界にも影響を及ぼし、企業の経営環境はここ数年にない厳しい状況が続いております。当社におきましても、下半期に予定しておりましたフォトマスク用寸法測定装置の販売は、取引先の開発投資の先送りと検収完了の期ずれから計画通りに進まず、当初の売上予想を大幅に下回る結果となりました。

今後、景気回復に転じるのは2010年以降と予想されており、開発投資に積極的な大手企業は、「技術力」が環境回復後の業績を左右するととらえ、次世代半導体製品の競争力の向上を目的とする最先端の設備投資を行っていきと考えられます。

そうした当社の顧客を満足させる製品を提供するため、当社は、製品開発を推進して性能アップを図り高性能化・高付加価値化を実現して商品力を強化してまいります。今後の方針として、

3つの施策と進捗について

2009年3月期は3つの施策を掲げ業績達成に向けて取り組んでまいりました。

半導体業界は依然として不透明な経営環境が続いておりますが、高性能化・高付加価値化や市場開拓等のより一層の取り組み強化を進めてまいります。

ACTION 1 —— 主力製品EMUの性能アップ(競争力)と新規市場開拓

ACTION 2 —— 電子スタンパーの高輝度LED市場への販売

ACTION 3 —— 台湾・中国市場の取り組み強化

1 主力製品EMUの性能アップ(競争力)と新規市場開拓

最新鋭機である「EMU-270A」は、次世代の32nm(ナノは十億分の一)ノード以降にも対応させるために分解能を大幅に向上させるべく研究開発を継続しております。DRAMをはじめとするメモリー市場の低迷から、半導体メーカーやマスクメーカーでは以前より引き続き設備投資の抑制や先送りが行われています。一部の半導体メーカーのみが、次世代の設備投資を行っており、装置メーカーはその受注をめぐり激しい性能競争を強いられています。

そのような状況下、「EMU-270A」は次世代の32nmノード以降にも対応させるために、低真空と収差補正器を搭載し、ダイナミック精度で0.3nmを実現いたしました。その結果、日本国内の大手メーカーより2台を受注し、1台は納入をしております。

今後さらなる性能アップとなる、レジストへの対応・スループット・チャージ対策を進め、世界一の装置を開発したいと考えています。



EMU-270A

電子ビームによりマスクの寸法が設計どおりに行われているかを測定する装置です。

CONTENTS

株主の皆様へ	1	財務諸表(要旨)	5-6
特集 今後の取り組み	2-3	株式情報、株主メモ、会社概要、役員	裏表紙
業績報告・HISTORY	4		

2 電子スタンプの高輝度 LED 市場への販売

LED (発光ダイオード) 生産用パターン転写装置である電子スタンプ「EBLITHO」は、昨年9月の未曾有の経済危機の影響からメーカーの投資計画がストップし、市場投入までは至りませんでした。しかし、当社は電子スタンプでのLEDの高輝度効果を実証しているため、主なユーザーへ装置の貸し出しを行い、その有効性を見出してもらうことで販売の成果を出したいと考えております。

また、最近ではLEDの市場以外に太陽光発電の応用や無反射防止膜のような市場もあることが分かり、新しい市場にも進出するべく市場調査をはじめております。



EBLITHO
LED生産用パターン転写装置
LED (発光ダイオード) 市場をターゲットとし、ステンシルマスクを利用した低加速電子ビーム高速転写装置です。

3 台湾・中国市場の取り組み強化

2008年5月にMARKETECH INTERNATIONAL CORP (MIC) 社と代理店契約を締結し、中国市場での販売強化を図ってまいりました。MIC社の持つ情報収集力と行動力を活かした営業で、中国大手の半導体メーカーからEMU-270を受注いたしました。

経済危機以前から中国・台湾を重要市場として位置づけておりましたが、今後もこの方針を継続し、引き続き受注獲得に取り組んでまいります。

MARKETECH INTERNATIONAL CORP (MIC) 社

1988年台湾で創立され、本部は台北にあり、中国、シンガポール、韓国、日本と米国に海外支社を有し、マーケティングとテクノロジー統合サポートサービスを専門とする代理店です。

News & Topics

1 東芝機械グループソリューションフェアに出展

東芝機械株式会社が開催しております東芝機械グループソリューションフェアが2009年5月20日(水)～23日(土)の4日間、静岡県沼津本社・工場で行われました。このフェアは、「超精密から超大型まで」を軸に、エネルギー、ナノ、エレクトロニクス、光学、自動車などのドメインに向けた『ものづくり』のあるべき姿をご提案するもので、当社の有する技術力をアピールすることができました。



2 製品の受注、納入実績

- 2009.5.21 フォトマスクメーカーよりEMU-270Aを受注
- 2009.5.1 中国大手メーカーよりEMU-270を受注
- 2009.3.2 国内大手メーカーよりEMU-270を受注
- 2009.2.24 国内大手メーカーにEMU-270Aを納入

当期の概況

当期におけるわが国経済は、米国発の金融危機をきっかけに世界経済の減速や急激な円高、株式市場の大幅な変動を背景に、企業収益や設備投資が急減するなど景気の悪化が鮮明となりました。半導体業界におきましても、企業の半導体関連部門は業績悪化に陥り、量産体制のもとでは生産調整や設備投資抑制など事業環境は厳しい状況で推移しました。

このような状況のもと、当社の主力製品であるフォトマスク用寸法測定装置「EMU」は、次世代半導体に向けた開発装置として半導体デバイスメーカー及びマスクメーカーの評価を受けてまいりましたが、取引先の開発投資計画の先送りと出荷したものの検収完了の期ずれから、当社の売上高は予想を大幅に下回る結果となりました。

また、LED (発光ダイオード) 生産用パターン転写装置である電子スタンプ「EBLITHO」につきましても、景気悪化からLEDメーカー各社は生産設備投資を抑制または順延するという厳しい状況により、当社は計画を達成することができませんでした。

その結果、製品事業の売上高は、前期比58.3%減少し36百万円となりました。その他事業につきましても、前期比44.1%減少し122百万円となりました。

上記の結果、当期の売上高は158百万円 (前期比48.1%減)、営業損失は639百万円 (前期営業損失326百万円)、経常損失は661百万円 (前期経常損失343百万円)、当期純損失は673百万円 (前期当期純損失409百万円) となりました。

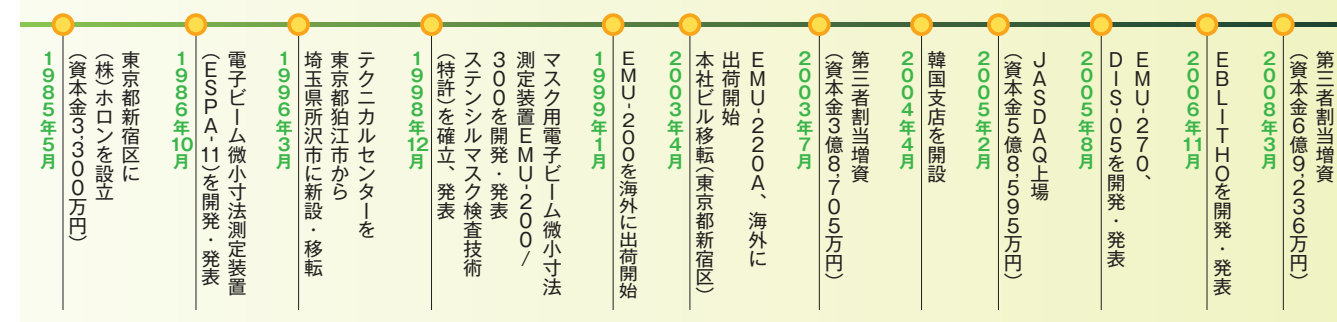
次期業績予想

今後の業績の見通しにつきましては、世界的な景気減速で半導体市場の低迷が長引くと予想され、当社にとって最大顧客であるマスクメーカー及び半導体デバイスメーカー各社の業績に与える影響等は依然として不透明であります。次期の上半期におきましてもこの傾向は継続すると予想されることから、なお一層の企業努力をいたしてまいります。

しかしながら、半導体の最先端技術は競争が進み、景気回復が予想される2010年を前に開発装置市場は活発化すると考えられることから、当社はまず、期ずれした検収完了と順延している商談の早期成立を目指し売上を確保するとともに、製品開発を推進することで製品性能アップを図り高性能化・高付加価値化を実現して商品力を強化し、顧客のニーズに合った製品を開発し新たな受注獲得に結びつけたいと考えております。

次期の見通しにつきましては、売上高1,010百万円、営業利益38百万円、経常利益35百万円、当期純利益27百万円を見込んでおります。

HISTORY



貸借対照表

科目	前期(23期) 平成20年3月31日現在	当期(24期) 平成21年3月31日現在
■資産の部		
流動資産	1,191	761
現金及び預金	210	208
受取手形	6	3
売掛金	58	29
有価証券	280	—
その他	635	518
固定資産	146	123
有形固定資産	94	87
投資その他の資産	51	36
資産合計	1,337	885

科目	前期(23期) 平成20年3月31日現在	当期(24期) 平成21年3月31日現在
■負債の部		
流動負債	128	365
固定負債	94	79
負債合計	223	444
■純資産の部		
株主資本	1,114	441
資本金	692	692
資本剰余金	635	635
利益剰余金	△213	△886
純資産合計	1,114	441
負債純資産合計	1,337	885

損益計算書

科目	前期(23期) 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで	当期(24期) 平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで
売上高	306	158
売上原価	191	400
売上総利益又は売上総損失(△)	115	△242
販売費及び一般管理費	441	397
営業損失	326	639
営業外収益	1	2
営業外費用	18	24
経常損失	343	661
特別利益	145	0
特別損失	209	11
税引前当期純損失	407	671
法人税、住民税及び事業税	1	1
当期純損失	409	673

キャッシュ・フロー計算書

科目	前期(23期) 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで	当期(24期) 平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	△206	△345
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	90	80
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	△11
現金及び現金同等物の増減額	△134	△283
現金及び現金同等物の期首残高	625	491
現金及び現金同等物の期末残高	491	208

株主資本等変動計算書 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
前期末残高	692	635	△213	1,114	1,114
当期変動額					
当期純利益	—	—	△673	△673	△673
当期変動額合計	—	—	△673	△673	△673
当期末残高	692	635	△886	441	441